СОДЕРЖАНИЕ

Номер 4, 2017

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ	
Интегрированные алмазные сенсоры с оптическим управлением А. В. Цуканов	247
ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ	
Влияние особенностей конструкции изолирующей щели открытых "Сэндвич"-структур $TiN-SiO_2-W$ и $Si-SiO_2-W$ на процесс их электроформовки В. М. Мордвинцев, С. Е. Кудрявцев	266
Расчёт высокочастотной электропроводности тонкого полупроводникового слоя в случае различных коэффициентов зеркальности его поверхностей И. А. Кузнецова, Д. Н. Романов, О. В. Савенко, А. А. Юшканов	275
плазменные технологии	
Кинетика травления меди в ВЧ-разряде фреона R-12 $A.~B.~Дунаев,~Д.~Б.~Мурин$	284
Влияние состава смеси на электрофизические параметры и спектры излучения плазмы $\mathrm{CF_2Cl_2/Ar}$ и $\mathrm{CF_2Cl_2/He}$ <i>С. А. Пивоваренок</i>	290
технологические процессы	
Оптимизация омических контактов к <i>n</i> -слоям гетеробиполярных наногетероструктур на основе арсенида галлия	
В. И. Егоркин, В. Е. Земляков, А. В Неженцев, В. И. Гармаш	295
Разработка методики локального легирования и коррекции проводимости эпитаксиальных слоёв PbSnTe путём диффузии индия из поверхностных нанометровых плёнок	
Д. В. Ищенко, Б. М. Кучумов	301
РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕМЕНТАХ И СИСТЕМАХ Диффузионная модель ионизационной реакции элементов БИС при воздействии ТЗЧ А. В. Согоян, А. И. Чумаков	305
Методика радиационной идентификации предприятия и характеризации технологии изготовления интегральных схем	
А. В. Согоян, Г. Г. Давыдов, А. С. Артамонов, А. С. Колосова, В. А. Телец, А. Ю. Никифоров, Ю. А. Ожегин, А. С. Каменева, Ю. М. Московская	313

Ä